****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader enquiries:** | **Press contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |



*Text and photograph available at:* [*https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases.html*](https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases.html)

Press release

8세대 Intel® Core™ 모바일 프로세서를 탑재한 congatec (콩가텍) 보드, 10년 이상의 가용성 보장

**긴 수명과 더불어 최고 58%의 성능 강화**

**Deggendorf, Germany, 11 June 2019 \* \* \*** 규격 및 맞춤형 임베디드 컴퓨터 보드와 모듈을 제공하는 업계 선도 기업인 congatec (콩가텍)은 오늘 8세대 Intel® Core™ 모바일 프로세서의 임베디드 버전을 출시한다는 소식을 발표했습니다(코드명 Whiskey Lake). 이 제품은 COM Express Type 6 콤팩트 모듈, 3.5인치 SBC 및 Thin-Mini-ITX 마더보드 사양으로 제공됩니다. OEM 고객은 이전 세대 임베디드 U 시리즈 프로세서에 비해 성능이 최대 58% 강화되는 이점을 누릴 수 있습니다. 이는 기존의 2코어 대신 4코어로 업그레이드하고 마이크로아키텍처를 전반적으로 개선한 덕분입니다. 옵션으로 제공되는 Intel® Optane™ 메모리 2나 USB 3.1 Gen2와 같은 기능 때문에 모든 작업의 응답성이 더욱 향상됩니다. 이 프로세서 코어는 효율적인 작업의 스케쥴링을 지원할 뿐만 아니라 RTS 하이퍼바이저 소프트웨어 사용을 지원하므로 입력 채널에서 프로세서 코어까지 I/O 처리량을 추가로 최적화해줍니다.

공간이 제한된 열악한 환경에 적합하도록 고안된 신제품 하이엔드 Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3 및 Celeron® 임베디드 프로세서 보드와 모듈은 업계 최초로 10년 이상의 장기 가용성을 보장합니다. 이처럼 완전히 새로운 임베디드 x86 설계 원칙은 congatec (콩가텍)에서 처음 선보이는 것으로, 최신 8세대 Intel® Core™ 모바일 프로세서 보드와 임베디드 보드 벤더[[1]](#endnote-1) 전체를 통틀어 최초로 출시됩니다. 새로운 보드와 모듈은 특히 운송과 모빌리티 업계에서 필요로 하는 수명 연장 요구 사항에 완전히 부합하며, 고객 측에서 추가 비용을 부담하지 않고도 긴 수명을 보장하기 때문에 다른 임베디드 애플리케이션(예: 의료 장비, 산업용 제어 장치, 임베디드 에지 클라이언트 및 HMI)에도 완벽하게 적합합니다.

“저희의 주요 목표 중 하나는 OEM 고객을 위해 임베디드 컴퓨터 기술 사용법을 가능한 한 단순하게 만들어드리는 것입니다. 그래서 신제품인 8세대 Intel® Core™ 모바일 프로세서 기반 임베디드 보드와 모듈은 기본적으로 10년 이상의 가용성을 보장하고, 특정 LTB 계약에 따라서는 처음부터 최장 15년의 장기적인 가용성을 보장하도록 출시했습니다. 사실 7년은 대부분의 하이엔드 임베디드 컴퓨팅 업계에서 부족하다고 느껴지는 경우가 많거든요. 이렇게 추가 비용 없이 수명을 연장함으로써 OEM 측에서는 자사 제품의 수명을 늘릴 수 있으니 지금보다도 더 나은 ROI를 보장하게 됩니다.”라고 congatec (콩가텍) 마케팅 책임자인 Christian Eder는 말합니다.

이전에는 대다수의 하이엔드 임베디드 애플리케이션이 7년 미만의 수명으로 제작되었습니다. 보통 그 정도 기간이 경과하기 전에 이미 다음 세대 프로세서로 성능을 강화해야 하는 경우가 많았기 때문입니다. 하지만 모바일이나 차량과 같이 다수의 새로운 임베디드 애플리케이션에서 인증 수요가 늘어나면서 최근 OEM에서는 더 긴 수명을 모색하게 되었습니다. 따라서 표준 임베디드 x86 플랫폼의 사용 수명을 10년, 나아가 15년까지 연장하면 임베디드 컴퓨팅 시장 전체에 걸쳐 고객은 큰 혜택을 누릴 수 있게 됩니다.

“새로 나온 Intel 아키텍처의 임베디드 버전에 10년 이상의 가용성까지 보장받을 수 있다니 정말 반가운 소식입니다. 사실 저희의 주 고객은 사용 환경이 열악한 모바일 애플리케이션인데, 이런 부문에서는 긴 수명이 중요한 요구 사항입니다. 고속 데이터 스트리밍이 지원되고 기록되어야 3D 사물 인식, 라이더 이미징과 모바일 매핑 등의 기능이 제대로 작동하기 때문입니다. 무선 네트워크 모니터링이나 자동차 테스트 시스템 또는 테스트용 차량의 데이터 로거의 경우도 마찬가지입니다.”라고 MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH의 CEO Thomas Hagios는 말합니다.

**세부 기능사항**

새로 출시될 conga-TC370 COM Express Type 6 모듈, conga-JC370 임베디드 3.5인치 SBC 및 conga-IC370 Thin Mini-ITX 마더보드는 모두 최신 Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3와 Celeron 임베디드 프로세서를 탑재하며 15년의 장기 가용성을 보장합니다. 메모리는 단일 플랫폼에 여러 OS 애플리케이션을 통합해야 한다는 요구 사항에 부합하도록 고안되었습니다. DDR4 SODIMM 소켓 두 개(최대 2400MT/s)가 제공되어 이용 가능한 용량이 최대 총 64GB에 달합니다. 업계 최초로 USB 3.1 Gen2(전송 속도 10Gbps)를 기본 지원하므로 USB 카메라 또는 다른 비전 센서에서 압축하지 않은 UHD 동영상도 전송할 수 있습니다. 신형 3.5인치 SBC가 USB-C 커넥터를 통해 이 기능을 제공하는데, 이 커넥터는 1x DisplayPort++를 지원할 뿐만 아니라 주변 기기의 전원공급장치로도 사용할 수 있으므로 비디오, 터치 및 전원까지 단 하나의 케이블로 모니터 연결을 완료할 수 있습니다. COM Express 모듈은 캐리어 보드에 설정된 것과 같은 기능을 지원합니다. 이외의 인터페이스는 폼팩터에 따라 각기 다르지만, 총 3개의 개별 60Hz UHD 디스플레이(최고 4096x2304px)는 물론 최고 1x 기가비트 이더넷(TSN 지원 포함 1x)까지 지원합니다. 새로 출시될 보드와 모듈은 이 모든 기능 외에 더 많은 인터페이스를 제공하며, 경제적인 15W TDP를 기본으로 10W(800MHz)부터 25W(터보 부스트 모드에서 최고 4.6GHz)까지 확장할 수 있습니다.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processor** |  | **Cores / Threads** |  | **Base freq. / Max. boost freq.[GHz]** |  | **Base TDP** **[W]** |  | **Temperature range** |
| **Intel® Core™ i7 8665UE** |  | 4 / 8 |  | 2.0 / 3.4 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Core™ i5 8365UE** |  | 4 / 8 |  | 1.8/ 2.6 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Core™ i3 8145UE** |  | 2 / 4 |  | 1.8 / 2.2 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Celeron® 4305UE** |  | 2 / 2 |  | 1.8 |  | 15 |  | 0 to +60°C |

8세대 Intel Core 프로세서 기술과 해당 congatec (콩가텍) 보드 및 모듈에 대한 자세한 정보는 다음 웹페이지를 참조하시기 바랍니다.
 <https://www.congatec.com/intel-whiskey-lake>

**About congatec**congatec is a leading supplier of industrial computer modules using the standard form factors COM Express, Qseven and SMARC as well as single board computers and customizing services. congatec’s products can be used in a variety of industries and applications, such as industrial automation, medical, entertainment, transportation, telecommunication, test & measurement and point-of-sale. Core knowledge and technical know-how includes unique extended BIOS features as well as comprehensive driver and board support packages. Following the design-in phase, customers are given support via extensive product lifecycle management. The company’s products are manufactured by specialist service providers in accordance with modern quality standards. Headquartered in Deggendorf, Germany, congatec currently has entities in USA, Taiwan, China, Japan and Australia as well as United Kingdom, France, and the Czech Republic. More information is available on our website at [congatec.com](https://www.www.congatec.com) or via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) and [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel, Intel Core and Intel Celeron are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*

1. congatec(콩가텍)에서 실시한 연구를 토대로 모든 주요 경쟁 업체의 최신 데이터시트를 근거로 하였습니다. [↑](#endnote-ref-1)